

# 2026年3月期 決算説明会資料

伯東株式会社  
2026年6月12日



東証プライム市場 | 証券コード7433



Part. 1

**2026年3月期決算概要及び  
2027年3月期業績予想**



Part. 2

**中期経営計画 Hakuto 2028の進捗**



Part. 1

# 2026年3月期決算概要及び 2027年3月期業績予想

# 2026年3月期決算概要

車載向け半導体デバイスやパワーデバイス向け装置の販売減少等により売上高は微減も、売上総利益は微増。新規事業やM&A関連の費用発生等による販管費の増加により営業利益と経常利益は減益となるが、政策保有株式の売却により当期純利益及びEPSは前期実績並みを確保

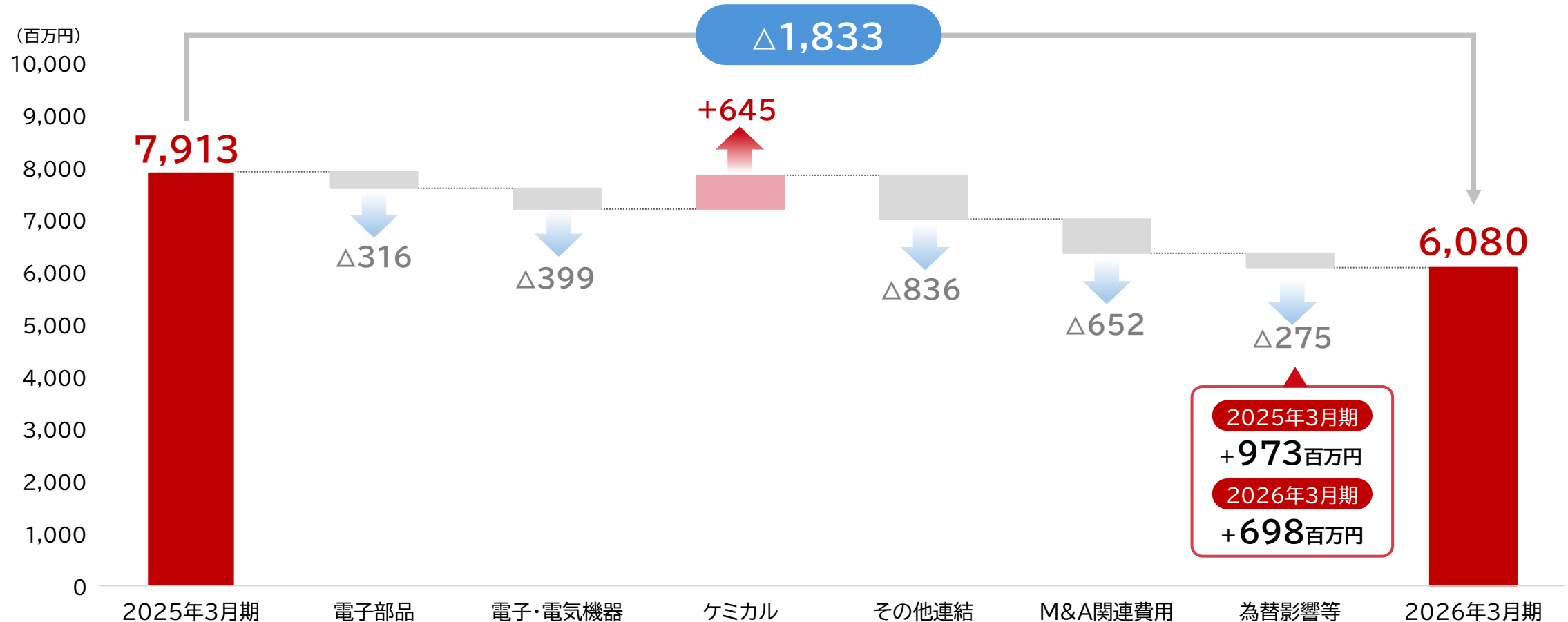
(百万円)

	2025年3月期	2026年3月期	前年同期比		
			増減額	増減率	
売上高	183,133	<b>181,178</b>	△ 1,954	△1.1%	車載向け半導体デバイス、パワーデバイス向け装置の販売減少等
売上総利益	27,878	<b>28,080</b>	+202	+0.7%	売上総利益率は前年同期より改善 <b>前期</b> 15.2% ▶ <b>当期</b> <b>15.5%</b>
営業利益	7,913	<b>6,080</b>	△ 1,832	△23.2%	新規事業やM&A関連の費用発生等による販管費の増加 <b>前期</b> 200億円 ▶ <b>当期</b> <b>220億円</b>
経常利益	7,321	<b>5,579</b>	△ 1,742	△23.8%	
当期純利益	5,131	<b>5,009</b>	△ 121	△2.4%	借入金の増加による支払利息の増加 <b>前期</b> 3.2億円 ▶ <b>当期</b> <b>4.3億円</b>
EPS※	272.76	<b>266.14</b>	△ 6.62	-	政策保有株式の売却により投資有価証券売却益22億円を計上

※ EPS:1株当たり当期純利益

# 連結営業利益の増減要因分析

- 電子部品と電子・電気機器は減益、ケミカルは石油・石化と化粧品基剤が堅調に推移し増益
- M&A関連費用として6.5億円を計上、その他はのれん償却費や新規事業関連費用等により減益
- 25.3期は為替変動(円安)により9.7億円、26年3月期は7億円の利益押し上げ要因



# セグメント別業績

- 電子部品は在庫調整、為替影響、M&A関連費用等、電子・電気機器は設備投資抑制により減収・減益
- ケミカルは海外向け化粧品基剤の販売回復により増収・利益計上
- その他は新規連結子会社の加入により増収も、のれん償却費や新規事業関連費用等により損失計上

(百万円)

		2025年3月期	2026年3月期	前年同期比	
				増減額	増減率
電子部品	売上高	142,961	<b>140,274</b>	△ 2,686	△1.9%
	セグメント利益	5,239	<b>3,933</b>	△ 1,306	△24.9%
電子・電気機器	売上高	27,241	<b>25,300</b>	△ 1,941	△7.1%
	セグメント利益	2,498	<b>2,083</b>	△ 414	△16.6%
ケミカル	売上高	10,789	<b>11,156</b>	+367	+3.4%
	セグメント利益	△ 9	<b>625</b>	+634	-
その他	売上高	2,560	<b>4,853</b>	+2,292	+89.5%
	セグメント利益	131	<b>△ 705</b>	△ 836	-
合計	売上高	183,553	<b>181,585</b>	△ 1,968	△1.1%
	セグメント利益	7,859	<b>5,936</b>	△ 1,922	△24.5%

**電子部品**

車載向け半導体デバイスの売上減少、為替影響、M&A関連費用等の発生により、減収・減益

**電子・電気機器**

顧客の設備投資抑制によりPCB関連やパワーデバイス関連機器の売上が減少し、減収・減益

**ケミカル**

石油・石化分野は国内向けが堅調推移、海外向け化粧品基剤も販売回復により、増収・利益計上

# 連結貸借対照表

- 連結子会社2社の取得(みなし取得日:2026年3月31日)に伴い、総資産は341億円の増加
- 仕入債務と有利子負債の増加等により、総負債は298億円の増加
- 為替換算調整勘定と非支配株主持分の増加等により、純資産は43億円の増加

(百万円)

	2025年3月期	2026年3月期※	増減額		
<b>総資産</b>	130,376	<b>164,484</b>	+34,108	連結CF参照	
現預金	14,929	<b>18,957</b>	+4,028		
売上債権	45,795	<b>56,868</b>	+11,073		
棚卸資産	44,484	<b>46,311</b>	+1,827		連結子会社の取得に伴う増加
のれん	3,028	<b>16,063</b>	+13,035		
投資有価証券	8,333	<b>8,557</b>	+224	保有株式の株価上昇による増加	
<b>総負債</b>	64,829	<b>94,651</b>	+29,822		
仕入債務	17,571	<b>22,551</b>	+4,980	短期、長期借入金の増加	
有利子負債	35,282	<b>58,031</b>	+22,749		
<b>純資産</b>	65,546	<b>69,833</b>	+4,287	為替変動による為替換算調整勘定の増加	
<b>自己資本比率</b>	50.3%	<b>41.6%</b>	—	連結子会社の取得に伴う非支配株主持分の計上	

※2026年5月25日に修正開示

# キャッシュ・フロー計算書

- 棚卸資産(新規連結子会社分は含まず)の減少等により、営業キャッシュ・フローは103億円の収入
- 子会社株式の取得等により、投資キャッシュ・フローは175億円\*の支出
- 短期、長期借入れにより、財務キャッシュ・フローは100億円の収入

(百万円)

	2025年3月期	2026年3月期	増減額
営業キャッシュ・フロー	10,589	<b>10,273</b>	△ 316
投資キャッシュ・フロー	△ 4,568	<b>△ 17,533</b>	△ 12,965
財務キャッシュ・フロー	△ 6,507	<b>10,017</b>	+16,524
換算差額	△ 152	<b>1,061</b>	+1,213
現金・現金同等物の増減額	△ 639	<b>3,819</b>	+4,458
現金・現金同等物の 期末残高	14,929	<b>18,749</b>	+3,820

税前利益: +78億円  
 売上債権の増加: △3億円  
 棚卸資産の減少: +31億円  
 仕入債務の増加: +5億円

---

投資有価証券の売却: +24億円  
 有形・無形固定資産の取得: △12億円  
 子会社株式の取得: △179億円

---

短期借入金の増加(純額): +70億円  
 長期借入金の増加(純額): 78億円  
 配当金の支払: △43億円

※2026年5月25日に修正開示

# 2027年3月期 連結業績予想

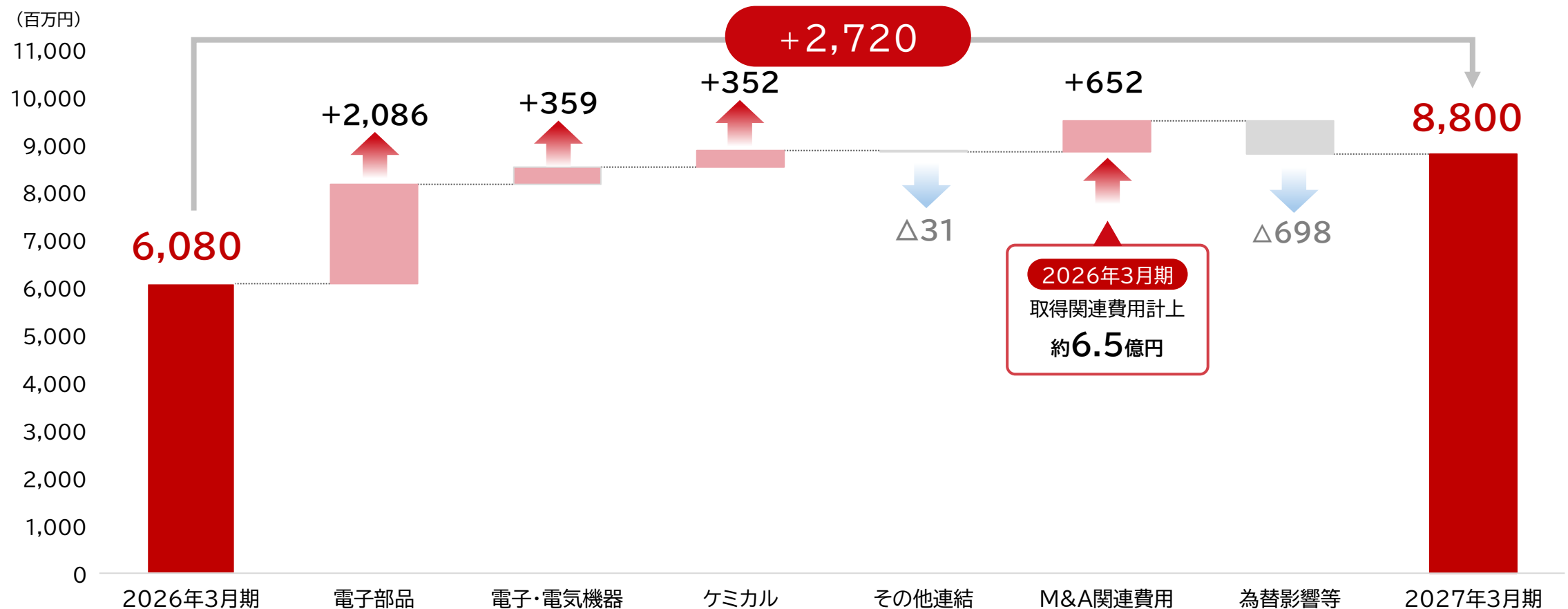
- 半導体市況の回復やAI関連の設備投資の活発化に加えて、新規連結子会社の損益寄与等により、増収・増益の見通し
- のれん償却費の増加等により販管費は22億円増加、投資有価証券売却益は15億円を見込む

	2026年3月期	2027年3月期			前年比	
	実績	上期(予)	下期(予)	通期	増減額	増減率
売上高	181,178	110,000	115,000	225,000	+43,822	+24.2%
売上総利益	28,080	15,400	17,600	33,000	+4,920	+17.5%
営業利益	6,080	3,400	5,400	8,800	+2,720	+44.7%
経常利益	5,579	2,900	4,600	7,500	+1,921	+34.4%
当期純利益	5,009	2,300	3,400	5,700	+691	+13.8%
EPS※	266.14円	—	—	302.77円	36.63円	—
ROE	7.5%	—	—	8.4%	0.9pt	—

※ EPS:1株当たり当期純利益

# 連結営業利益の増減要因(対26/3期実績比)

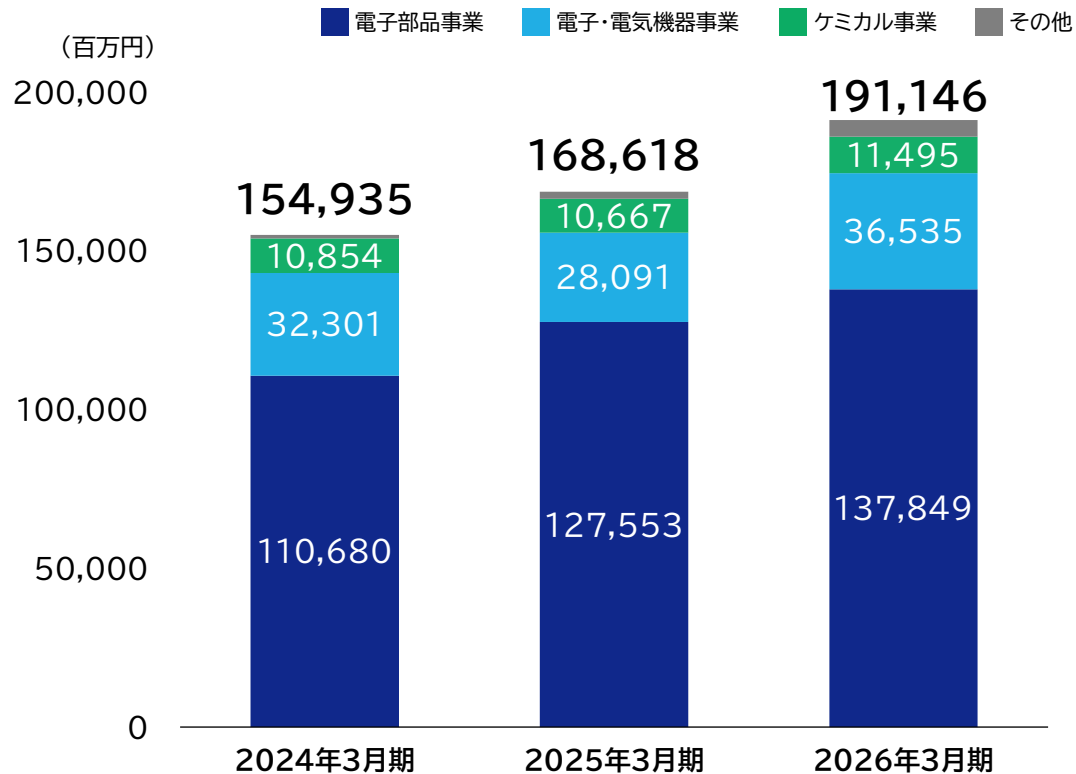
- 電子部品は、半導体市況の回復と新規連結子会社の損益寄与により大幅増益を見込む
- 電子・電気機器は、AI半導体向け先端パッケージ関連装置の需要拡大で増益を見込む
- 2026年3月期は為替影響により7億円の利益押し上げ、M&A関連費用6.5億円を計上



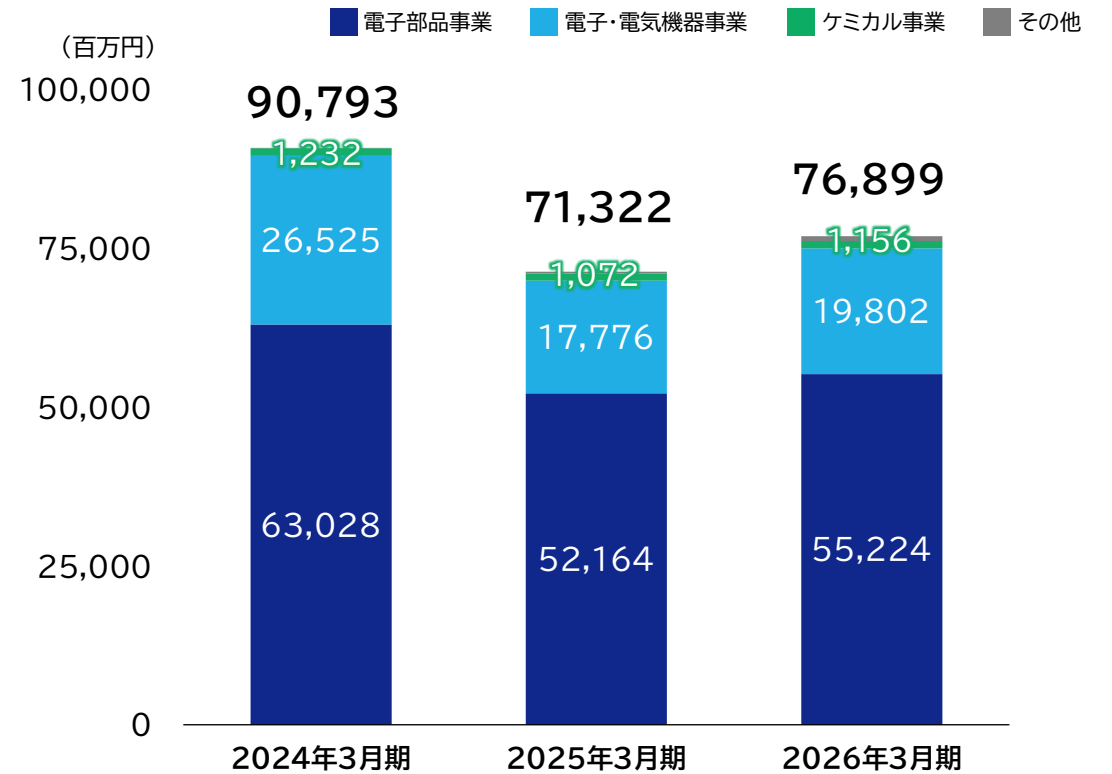
# 連結受注高・受注残の推移

- 電子部品事業は、AI需要によるメモリー不足や次世代高速通信向け投資を背景に拡大傾向
- 電子・電気機器事業は、AI半導体向け先端パッケージ用の装置需要が拡大し、受注高が大幅増
- 2026年3月期の新規連結子会社の受注高・受注残は含まず

受注高 ※



受注残 ※



※2026年5月25日に修正開示

## 2027年3月期配当予想

- 中期経営計画(2026年3月期～2029年3月期)における配当は、配当性向70%(±5%)に加えて、DOE5%を下限として設定
- 2027年3月期は1株当たり年間配当金220円(中間110円、期末110円)を見込む

		2025年3月期	2026年3月期	2027年3月期(予想)
1株当たり配当金 (単位:円)	中間	130	100	110
	期末	130	100	110
	年間	260	200	220
配当金総額 (単位:百万円)	年間	4,892	3,765	—
配当性向		95.3%	75.1%	72.7%
純資産配当率 (DOE)		7.4%	5.6%	6.1%

A thick, red diagonal bar that tapers from top-left to bottom-right, positioned to the left of the text.

Part. 2

# 中期経営計画 Hakuto 2028の進捗

1

## AIの爆発的普及と データセンター需要の急拡大

機会

- AIサーバー向け高性能半導体、大容量メモリ、高速光通信デバイスの需要急増
- AI向け最先端半導体微細化に伴う前工程の歩留まり改善ニーズの高まり。海外製ニッチトッププロセス装置や高度なウェハ検査・測定機器の導入機会が拡大
- 先端パッケージング(後工程)向け製造・検査装置、およびデータセンター向け基板製造装置の特需獲得

リスク

- AI向け最先端製品への需要偏重による、汎用半導体の市況回復遅延
- テクノロジーの急激な変化や需要変動に伴う、過剰在庫・仕入先変更リスク

2

## 半導体の戦略物資化と サプライチェーンの再編・国内回帰

- 九州・北海道をはじめとする国内半導体工場(前工程・後工程双方)の新設に伴う、製造装置や検査機器の大型納入機会の到来
- 工場のインフラ設備(排水・水再利用施設)向け水処理ケミカル・機器の需要拡大
- 地産地消・国内調達ニーズの高まりによる、国内商流の新規開拓

- 米中対立等の地政学リスク顕在化による輸出入規制の強化
- グローバルサプライチェーンの分断に伴う部材の調達制約、および仕入先コンプライアンスリスクの上昇

3

## 脱炭素・サーキュラーエコノミー に向けた環境要求の高度化

- 工場インフラの省エネ・資源リサイクルに直結するプロセス用ケミカルや環境ソリューションの販売機会創出
- EV、再生可能エネルギー、データセンター等の省電力化に寄与するパワー半導体の拡販

- 各国における環境規制(化学物質規制など)の強化に伴う、既存ケミカル製品の改良コストや代替品開発コストの発生
- 装置自体の省電力化要求に対する開発・対応コストの増大

# 経営目標の見直し

Rabyte社のM&A実施やAI・データセンター関連需要の拡大を踏まえ、売上高計画を上方修正し、EBITDAを経営目標に追加

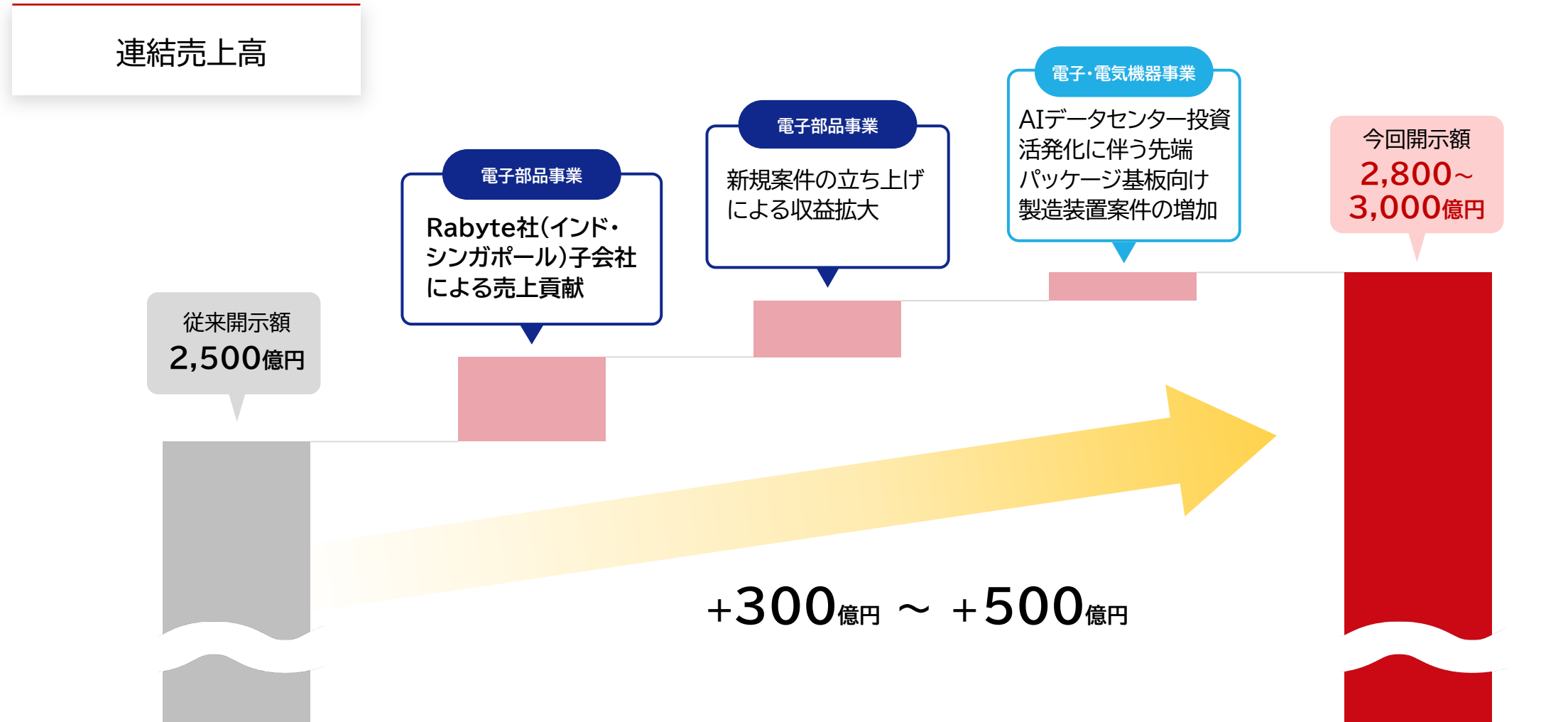
	2025年3月期 実績	2026年3月期 実績	2027年3月期 予想	2029年3月期 当初目標	2029年3月期 修正目標
売上高	1,831億円	1,811億円	2,250億円	2,500億円以上	2,800~3,000億円
EBITDA <small>(※1)</small>	93億円	78億円	113億円	115億円以上	135~155億円
営業利益率 <small>(為替影響除く)</small>	3.8%	3.4%	3.9%	4.0%以上	4.0%以上
ROE	7.8%	7.5%	8.4%	10%以上	10%以上
株主還元	総還元性向 95%	配当性向 75.1% DOE 5.6% <small>(※2)</small>	配当性向 72.7% DOE 6.1%	配当性向 65~75% 加えて下限値DOE 5%	配当性向 65~75% 加えて下限値DOE 5%

※1 EBITDA=利払い前・税引き前・減価償却前利益。今回の修正計画より設定

※2 DOE=純資産配当率

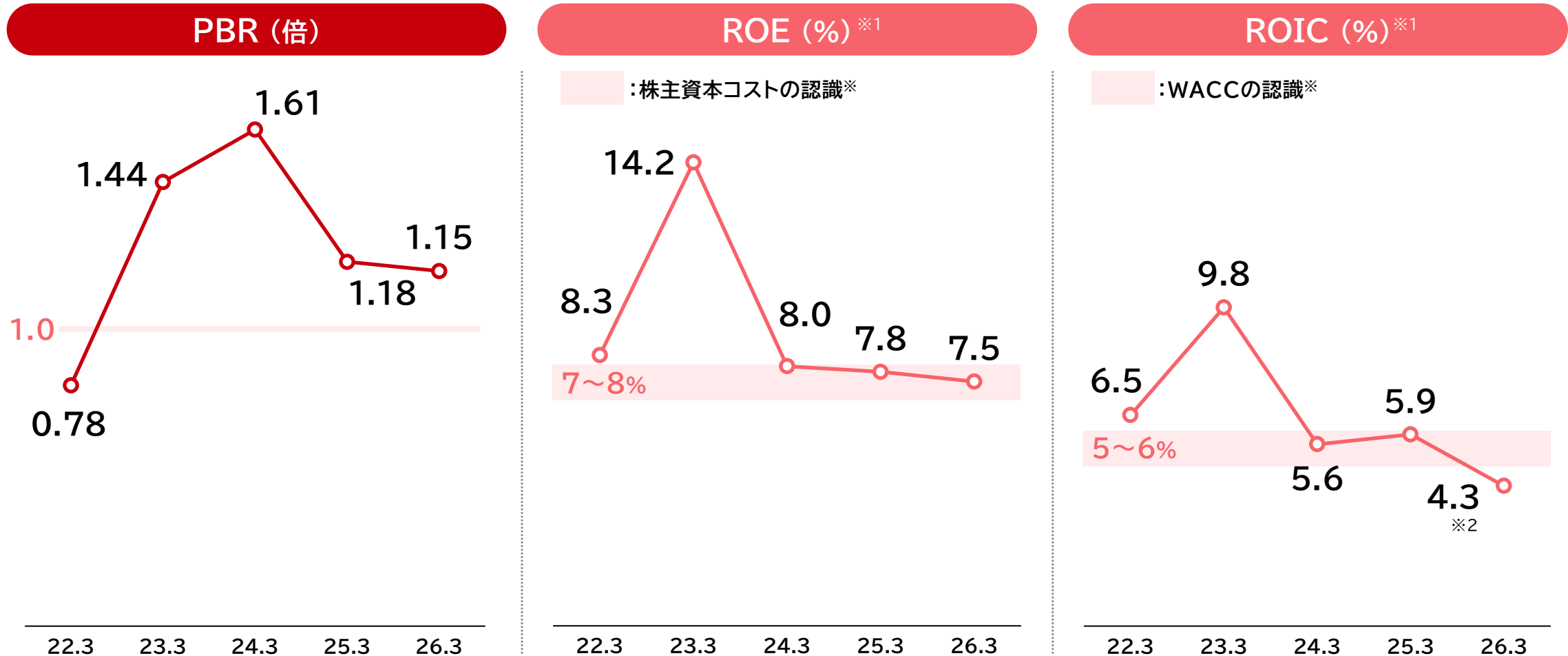
# 2029年3月期売上高計画見直しの背景

Rabyte社の加入、電子部品、電子・電気機器事業でのアップサイド見通しを反映



# 資本市場における当社の現状

足元PBRは1倍超もROEは7.8%、ROICは5.9%と、株主資本コスト、WACCの認識と同水準。  
 持続的な企業価値向上に向けては、資本効率を意識したROE改善が必要



※1 ROEは当期純利益/自己資本、ROICは(営業利益×(1-実効税率))÷投下資本(投資その他の資産を含む固定資産+運転資本)で算出。自己資本、投下資本は期中平均。株主資本コスト、WACCはCAPMに基づく  
 ※2 26.3期はのれん影響を除いて算出

基本方針

顧客優位で価値の向上に取り組む

成長戦略の  
粗利益貢献率 30%目標

基本戦略

事業戦略

価値の複合化と新規創出

- 顧客課題に応じたソリューションの複合化
- 全社横断組織で加速する新規事業の創出とスケール化
- M&A・資本提携による新たな価値の獲得

基盤強化戦略

事業戦略を加速する人材確保とDX投資

- イネーブラーを体現する人材の確保と育成
- 効率化と提供価値の向上を両立するDX

財務・資本戦略

積極的な成長投資と安定的な株主還元

- 成長と還元のバランスを重視したキャピタルアロケーション
- 資本コストを意識した経営の推進
- DOEの導入による安定的な株主還元

進捗度



ここまでの主な実績  
/今後の主な戦略

- 新規事業の開発に特化した「ビジネスインキュベーションセンター」を新設
- インド・シンガポールのエレクトロニクス商社、Rabyteを子会社化
- AI、データセンター向け半導体需要の拡大を捉えたビジネスの拡大

- 全社人材要件である「Think・Drive・Refine」を軸に、リスクリングの環境整備を実現。また、戦略実現に接続される人材ポートフォリオの整備を段階的に実施中
- ヘッドライト経営実現のために「S&OPプロジェクト」による需給計画のデジタル化を推進
- 「AIワークフォース」を立ち上げ、AIを安全・安心に活用するためAIガバナンス構築を開始

- ROICマネジメントの高度化の推進(サプライヤー別ROICマネジメントなど)
- 成長投資としてRabyteを子会社化を実行
- 2026年3月期:配当性向75.1%、DOE5.6%

# M&A・資本提携の推進

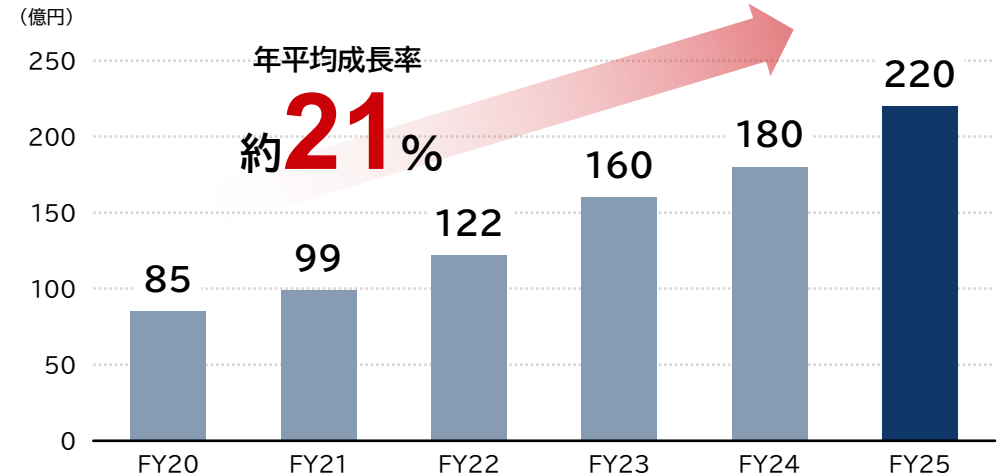
2026年2月にインド・シンガポールのエレクトロニクス商社、RabyteがM&Aによりグループイン。  
インド半導体市場に本格参入



株式取得日	2026年2月
ターゲット領域	市場開拓、市場深耕
事業内容	電子部品・半導体製品の提供、製品開発、設計・ソリューション支援、サプライチェーン管理、検査機能を提供
取得目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>インド、東南アジア、ANZ地域の顧客基盤拡充</li> <li>クロスセルによるシナジー発揮</li> </ul>
シナジーイメージ	<ul style="list-style-type: none"> <li>両社の取扱製品群の既存顧客へのクロスセル</li> <li>Rabyte社の設計機能及びサービスを当社既存顧客へ提供</li> </ul>

売上高推移※

※1ドル150.23円で換算



## Rabyteの投資魅力

- ① インド、ASEAN地域での地位確立
  - インド、ASEAN地域で強い存在感と約3,000社とのコネクションを保有
- ② 顧客ニーズに合わせたカスタマイズ機能
  - 製品開発、既製品及びカスタマイズソリューションを提供し、顧客ごとのニーズに対応
- ③ 明確な成長戦略と市場成長性
  - インドの半導体市場はサプライチェーンの分散ニーズやインド政府の支援などにより、成長トレンド

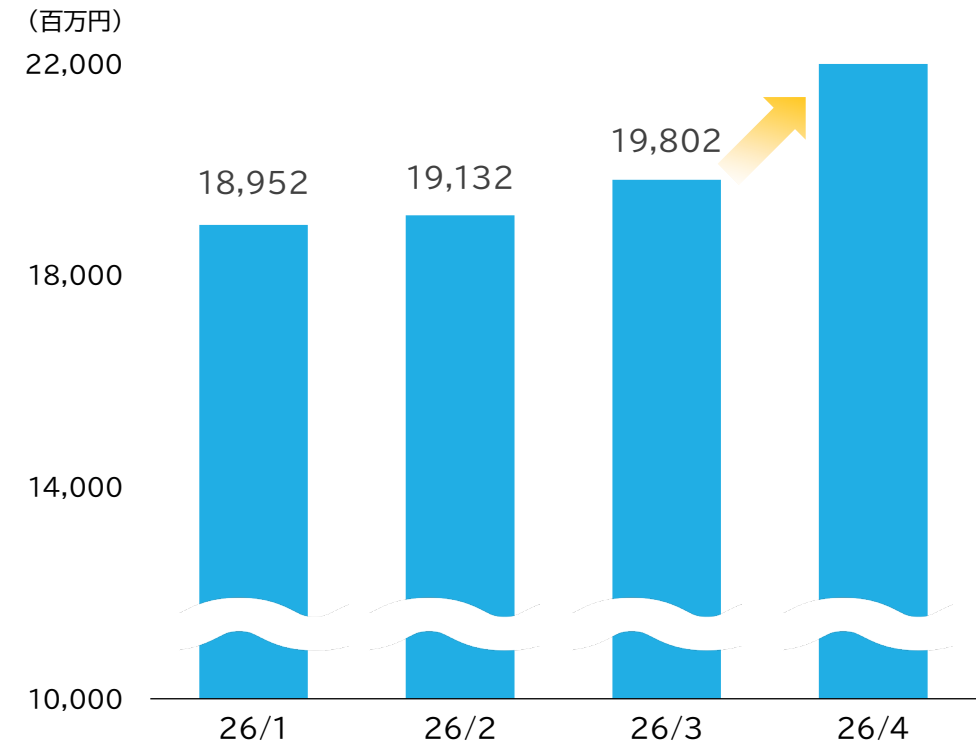
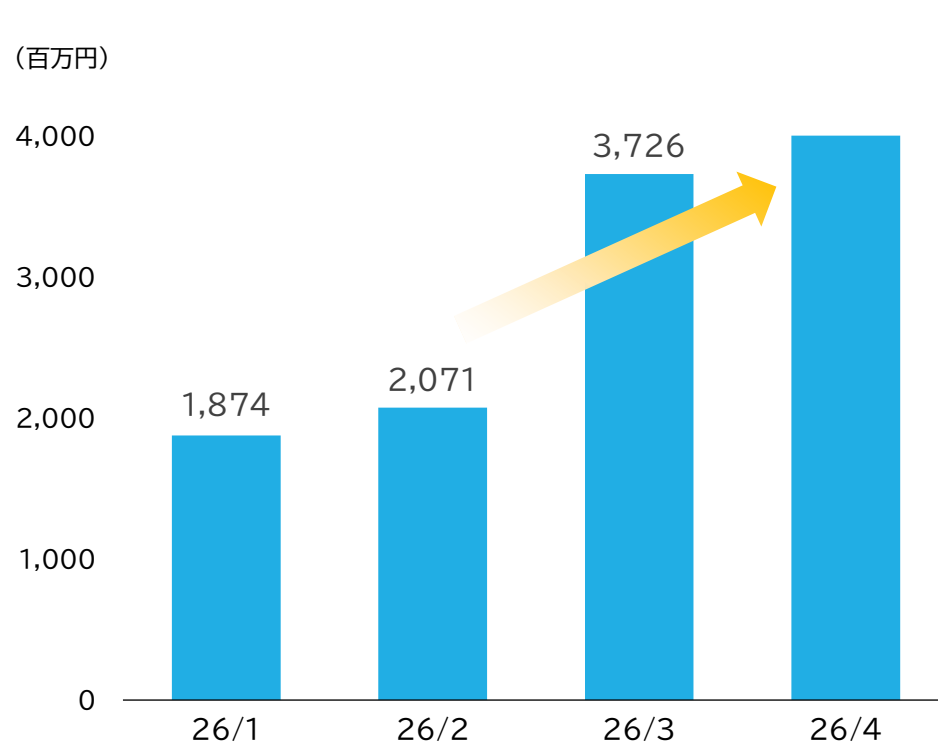
## AI、データセンター向け半導体需要の拡大を捉えたビジネスの拡大①

AI需要を背景にしたデータセンター向け投資の拡大を受け、先端半導体製造の課題解決に貢献する装置・機器の需要が増加。こうした環境を追い風に、当社の電子・電気機器事業の受注も2026年に入り伸長

### 電子・電気機器事業(連結)

受注高

受注残



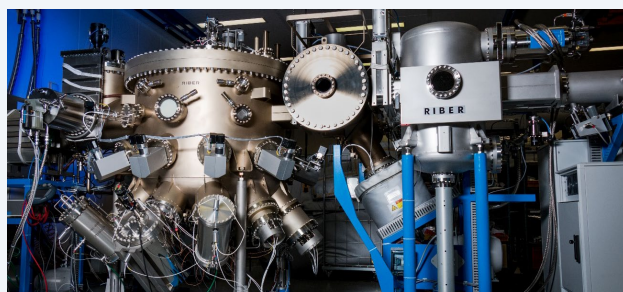
# AI、データセンター向け半導体需要の拡大を捉えたビジネスの拡大②

## AIデータセンター向け半導体の課題解決に向けた貢献事例



Riber社

分子線ビームエピタキシー



量子ドットレーザーを用いたレーザー装置。次世代「光電融合」のコア技術に寄与。26年1月にQDレーザから同装置を受注。他の国内化合物半導体デバイスメーカーからの受注にも期待

エヌエス社/伯東

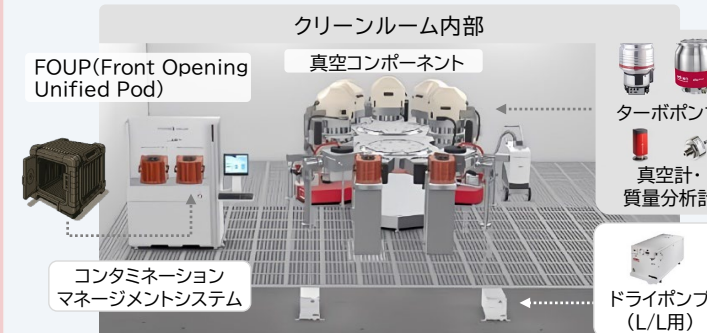
イオンビームミリング装置



放熱性に優れた回路基板(セラミックス他)に対し、ウェットエッチングでは回路形成が困難な素材加工を実現

Pfeiffer社

汚染監視システム&SPTI/  
Load port purge system



HBMなどの先端DRAM製造において、製造装置や搬送部の汚染を監視・抑制することで、歩留まり向上や不良低減に貢献

# AI、データセンター向け半導体需要の拡大を捉えたビジネスの拡大③

「次世代パッケージング」技術＋ソリューションで顧客ニーズに対応

## 半導体後工程

半導体前工程  
微細化の限界

AI/HPC向け  
先端パッケージング  
の需要増

中国、韓国、台湾  
などアジア諸国  
から強い引き合い

## パッケージング関連装置の開発・販売



顧客



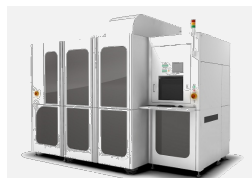
抱えている課題

チップレット技術

省電力化と高速化

歩留まり改善

## 次世代パッケージング向け当社主力製品



ステッパー

・微細化に貢献



ラミネータ

・基板が高多層になっても歩留まりを維持



ドライクリーナー

・微細化に貢献  
・歩留まり改善に貢献



自動搬送装置

・省人化・自動搬送による歩留まり改善



## + αソリューション



### 設置・運用支援

- ・定期メンテナンス＆オーバーホール
- ・機器の設置＆フィールドサービス



### モニタリング支援

- ・DXを活用した遠隔監視・予知保全



### 開発支援

- ・電子機器の開発支援
- ・試験環境の提供
- ・製造サービス（パートナー会社）
- ・デザインサービス

➡ 顧客ニーズや技術トレンドを踏まえ、製品ラインアップ拡充を推進

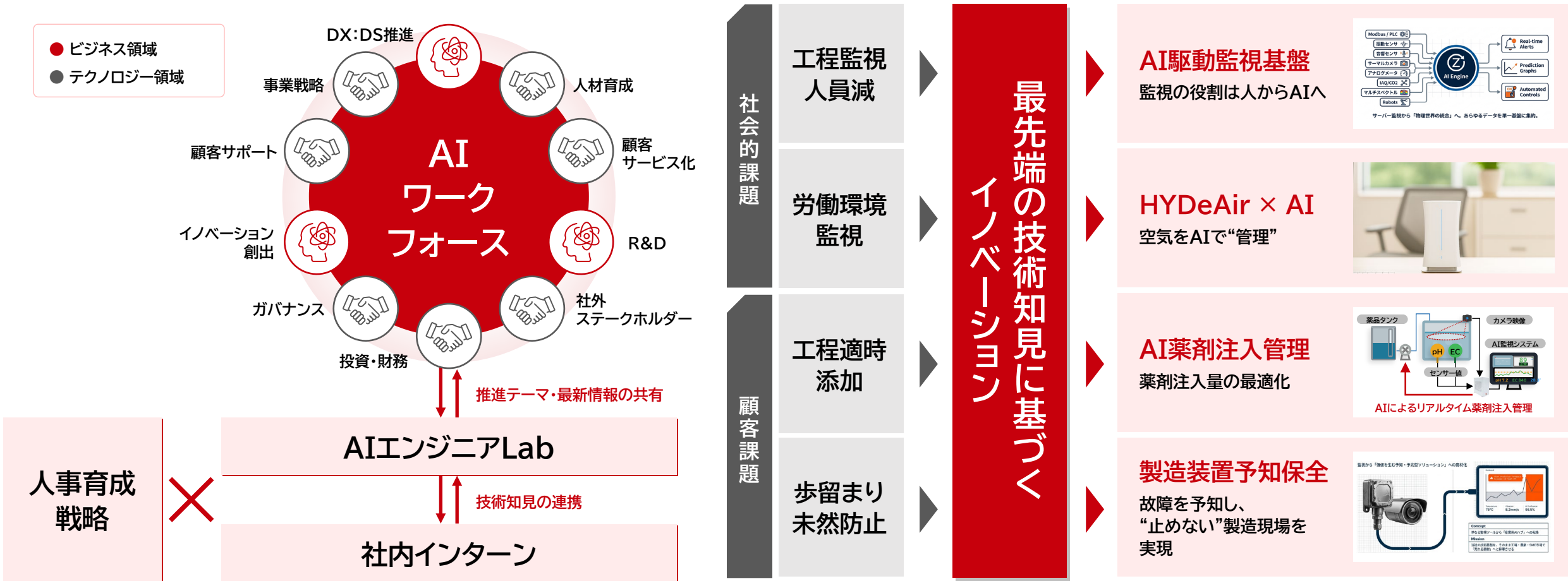
自社オリジナル製品の開発

新規サプライヤーの開拓

M&Aによる隣接領域への展開

# AI活用に向けた組織的な取り組みの推進

AI活用に関わる関係者をつなぐ「AIワークフォース」を中核に、IT・デジタル技術を積極的に活用した全員参加型のDXを推進。AI領域に強い人財を育成しながら各取り組みを連動させ、部門横断のAI戦略を推進

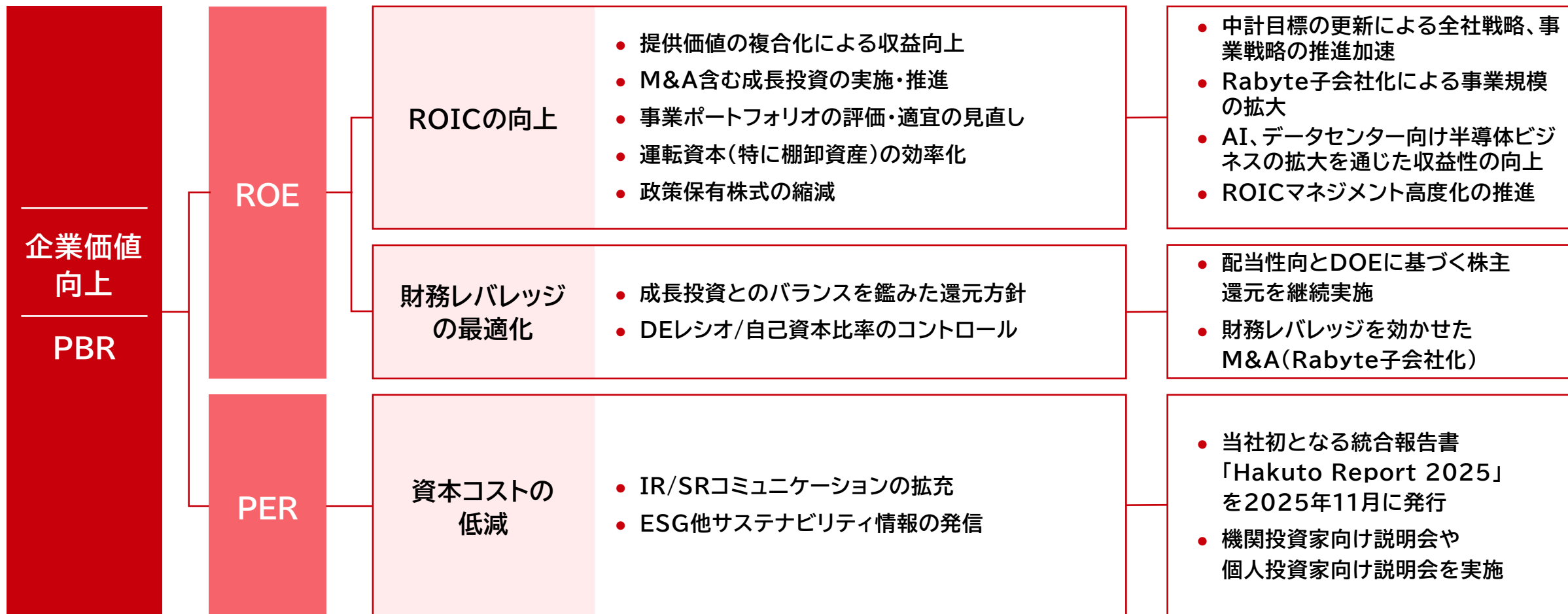


# 資本コストを意識した経営の推進

「中期経営計画 Hakuto 2028」にて掲げた経営方針に基づくROIC経営を推進中

## 中期経営計画（2025年4月公表）の資本コスト経営方針

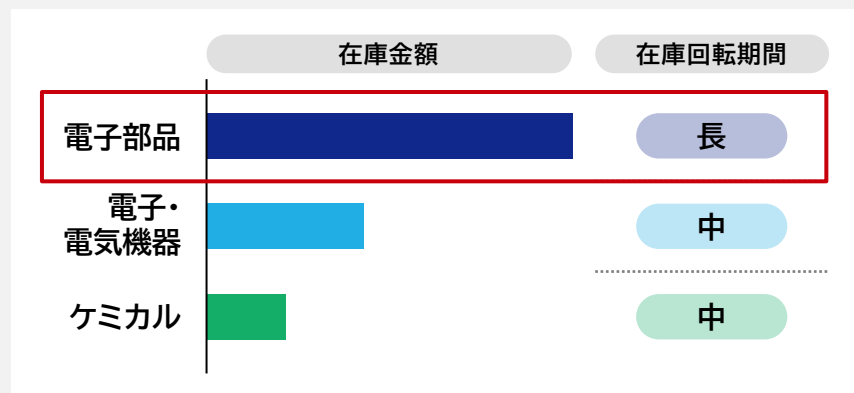
## 取り組み状況



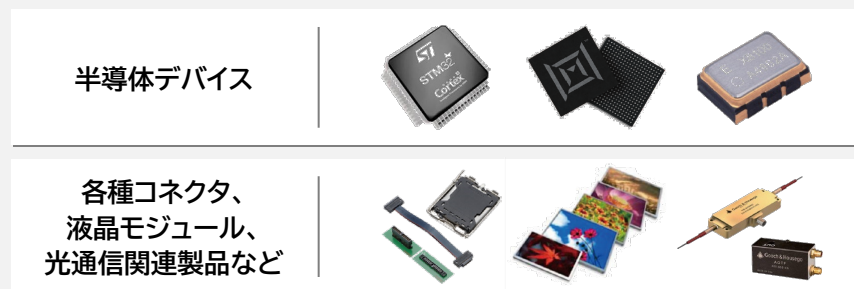
# ROICマネジメント高度化の推進

電子部品事業は他事業部に比べ在庫が多く、また在庫回転期間も長い。加えて、製品ラインアップも多岐に渡り、ROICマネジメントが特に重要。3つのSTEPでROICマネジメントの高度化を推進

## ■ 事業別在庫と在庫回転期間のイメージ



## ■ 主な取り扱い製品



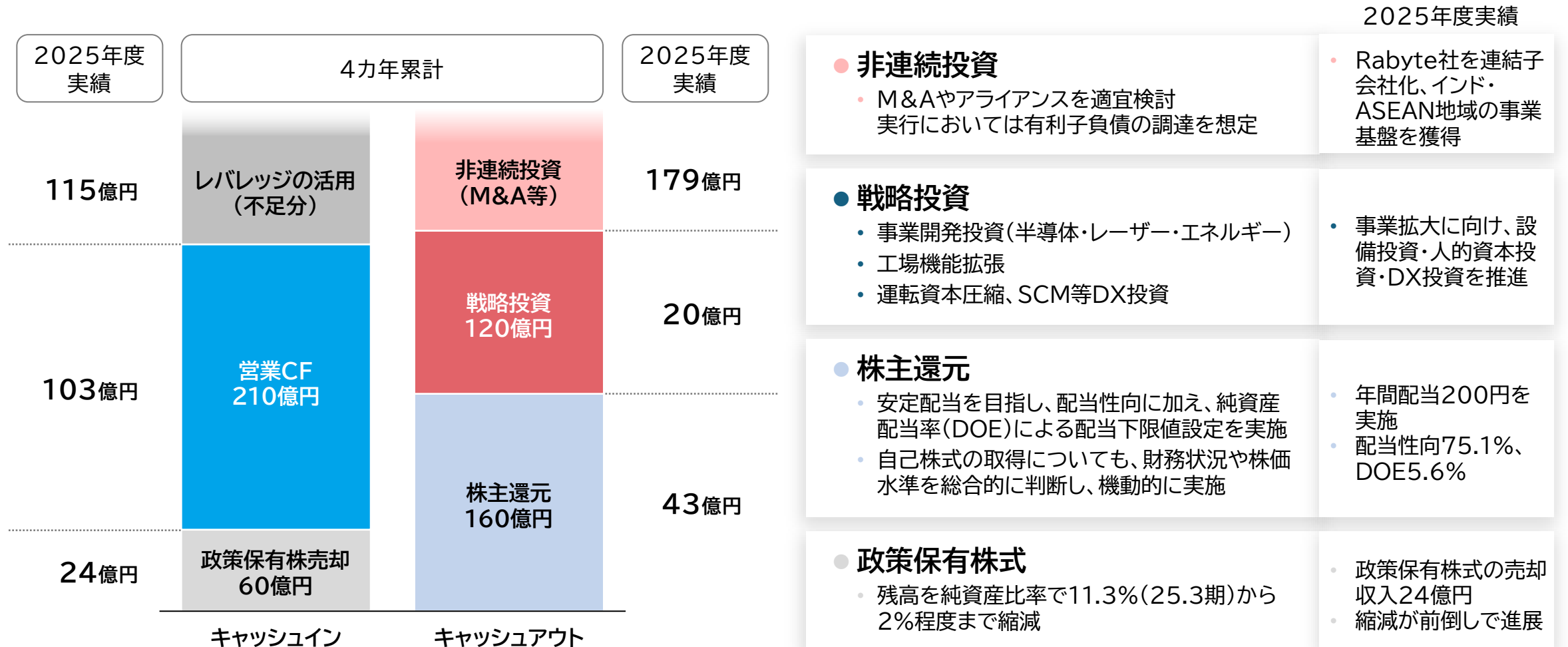
## ROICマネジメント高度化ロードマップ



# キャピタルアロケーションの実行状況

政策保有株式の縮減が前倒しで進展、M&Aを通じた成長投資と株主還元を実行

## 中期経営計画 (2025年度~2028年度累計)



本資料にて記載されているデータ及び将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により変化する可能性があります。従いまして、本資料は記載された目標・予想の達成及び将来の業績を保証するものではありません。

---

IRに関するお問合せ先  
経営企画部 Tel.03-3225-8931